

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2005年3月17日 (17.03.2005)

PCT

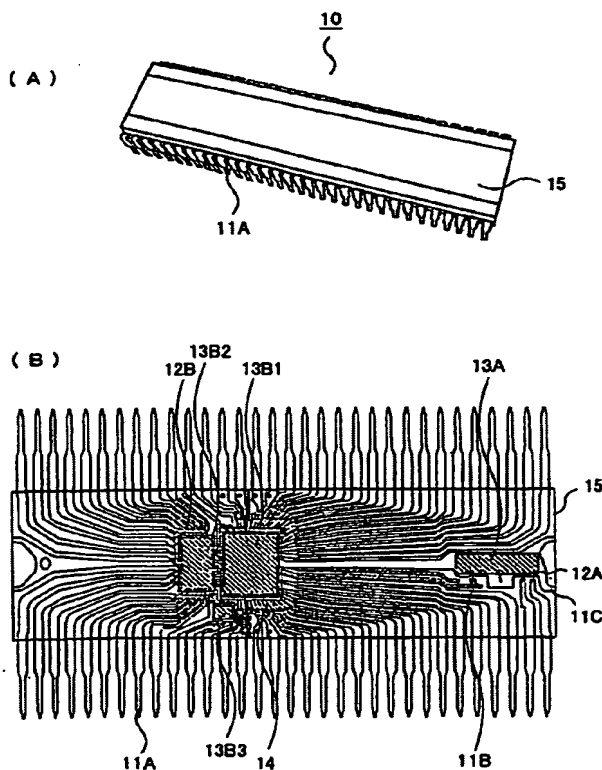
(10) 国際公開番号  
WO 2005/024947 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 25/04, 25/18, 21/56, 23/50  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/013002  
(22) 国際出願日: 2004年9月1日 (01.09.2004)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ: 特願2003-310763 2003年9月2日 (02.09.2003) JP  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三洋電機株式会社 (SANYO ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通二丁目5番5号 Osaka (JP). 関東三洋セミコンダクターズ株式会社 (KANTO SANYO SEMICONDUCTORS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒370-0533 群馬県邑楽郡大泉町仙石二丁目2468番地1 Gunma (JP).

- (72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 今泉 英雄 (IMAIZUMI, Hideo) [JP/JP]; 〒370-0344 群馬県新田郡新田町早川20-78 Gunma (JP). 加藤 卓治 (KATO, Takuji) [JP/JP]; 〒360-0017 埼玉県熊谷市大字小曾根371番地7 Saitama (JP). 中島 憲一 (NAKAJIMA, Kenichi) [JP/JP]; 〒348-0005 埼玉県羽生市上村君847-2 Saitama (JP). 針谷 正巳 (HARIGAI, Masami) [JP/JP]; 〒326-0836 栃木県足利市南大町105-3 Tochigi (JP). 桑田 将愛 (KUWATA, Masachika) [JP/JP]; 〒370-0401 群馬県新田郡尾島町尾島253-3 Gunma (JP). 落合 公 (OCHIAI, Isao) [JP/JP]; 〒373-0025 群馬県太田市熊野町11-14 Gunma (JP). 坪野 谷 誠 (TSUB-ONoya, Makoto) [JP/JP]; 〒370-0513 群馬県邑楽郡大泉町東小泉2-22-9 Gunma (JP). 渋沢 克彦 (SHIBUSAWA, Katsuhiko) [JP/JP]; 〒370-0500 群馬県邑楽郡大泉町986-5 Gunma (JP). 高瀬 巖 (統策有)

(54) Title: CIRCUIT DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: 回路装置およびその製造方法



(57) Abstract: Disclosed is a circuit device wherein a plurality of circuit elements including a circuit element having a hollow space inside are sealed with a resin. Also disclosed is a method for manufacturing such a circuit device. A circuit device (10) comprises a first circuit element (13A) having a hollow space inside and a plurality of second circuit elements (13B) electrically connected with the first circuit element (13A). The first circuit element (13A) and the second circuit elements (13B) are sealed with a sealing resin (15). The distances between the first circuit element (13A) and each second circuit element (13B) are longer than the distances between respective second circuit elements (13B).

(57) 要約: 課題 内部に空隙を有する回路素子を含む複数の回路素子を樹脂封止した回路装置およびその製造方法を提供する。解決手段 回路装置10は、内部に空隙を有する第1の回路素子13Aと、第1の回路素子13Aと電気的に接続される複数の第2の回路素子13Bとを有する。第1の回路素子13Aおよび第2の回路素子13Bは封止樹脂15により封止される。第1の回路素子13Aと第2の回路素子13Bとが離間する距離は、第2の回路素子13B同士が離間する距離よりも長い。